

海外并购此起彼伏

中国半导体企业整合进入2.0时代

□本报记者 傅嘉

下半年以来，国内半导体产业并购迭创高潮。近期通富微电和紫光股份接连祭出的海外并购计划，预示着半导体产业并购整合进入到新的2.0时代，即从国内资源的存量整合开始进入到海外购买资产的阶段。

分析人士指出，半导体产业并购潮起是经济结构转型的大势所趋，中国企业正在成为全球半导体产业扩张的主要力量，中国半导体产业的不断壮大将深刻影响全球半导体产业的格局。

通富微电瞄准AMD资产

通富微电10月18日晚公告称，公司拟联合国家产业基金等以现金方式收购AMD位于苏州和马来西亚槟城两座封测工厂85%的股权，对价3.7亿美元。AMD苏州和槟城工厂是AMD从事处理器封装测试的资产，CPU、GPU等处理器的年封装能力超过6000万块，测试能力超过8000万块。

据测算，两家工厂净利润率水平在4%-5%左右。截至2015年6月30日，合并净资产和负债分别为17.1亿元和4.6亿元，负债率21.2%（全部经营性负债）。收购PB为1.62倍，PE为25.0（2014年）和21.8倍（预测2016年），PS为1.1倍。

中投证券分析称，通富微电和AMD苏州/槟城在营收规模和盈利能力上基本相当，2014年合并营收达到7.3亿美元左右（合46.2亿元人民币），全球排名在7-8位。假设公司全额出资和50%出资两种情境下，公司权益营收规模增加幅度分别为103%和78%，权益净利润增加幅度分别为51.7%和39%。

通富微电的此举，不仅将大大加大在封装领域的产业规模，也将影响大陆的产业格局。中投证券指出，通富微电前期与华虹宏力、华力微电子在Bumping和FC等领域结成战略同盟，构成大陆先进封装第二力量。未来大陆Foundry和先进封装领域将形成“中芯国际+长电科技”或“华虹宏力+通富微电”两大力量。

此次收购还有利于拓展通富微电的产品线。标的公司掌握并应用着PGA、BGA、LGA等世界先进的封装技术，终端应用领域主要为PC机和服务器的CPU、显卡等产品。上市公司之前的产品主要应用于移动智能通讯、汽车电子等领域，此次收购可以成功切入PC机和服务器的CPU、显卡等芯片的封测领域。另外，标的公司的产线经过一定的改造，还可以为上市公司现有客户和业务提供产能弹性，与上市公司形成一定的协同效应。

海通证券认为，大基金（国家集成电路产业投资基金）会成为收购平台通润达的战略投资者，将与上市公司共同对通润达增资和（或）以债务形式为通润达提供资金支持。这次大基金在封测领域是继支持长电科技并购星科金朋后的第二次出手。

从产值角度看，存储器和微处理器是半导体产业的两大件，分别占半导体产品产值的22%和19%。发展半导体产业，存储器和微处理器是绕不开的课题。支持通富微电收购AMD的封测资产，显示出国家对CPU封测技术的高度重视。不排除国内在CPU方面有其他运作的可能，与此次收购的AMD封测资产有效地结合。

今年上半年北京建广资产管理有限公司宣布拟以18亿美元的价格收购恩智浦半导体旗下射频功率事业部——RF Power，开启了中国半导体行业真正走出去收购海外资产的大并购之旅。结合当前的市场情况，中国半导体企业在海外并购之路上已经开始提速。

半导体上市公司前三季度业绩趋暖

□本报记者 傅嘉

截至10月19日，两市共有18家半导体上市公司披露前三季度业绩情况。1-9月，18家公司中，有1家公司扭亏，11家公司业绩录得同比正增长。今年以来，能过经营结构的不断调整，虽然下游驱动仍然偏弱，但是半导体上市公司业绩状况普遍得到改善。

多公司业绩走强

去年业绩不佳的君正电子今年前三季度业绩反转。公司预计，前三季度实现净利润3850.51万元至4306.82万元。而公司上年同期业绩亏损129.23万元。

君正电子上市后的主业是基于公司自主设计的MIPS架构XBurstCPU内核的JZ47xx系列微处理器芯片，但移动电子市场开拓不利，多媒体播放器和教育类电子产品遭遇平板、智能手机等产品巨大冲击，公司前三季度业绩一直表现不佳。

为了避免对单一市场的过度依赖，公司不断优化智能手表、智能眼镜以及WIFI音箱等方案，积极拓展芯片产品的应用领域。继Newton平台、Halley平台之后，公司又推出Venus开发平台，有助于公司智能手表生态圈的建设。为避免对单一市场的过分依赖以及可穿戴设备市场的不确定因素，公司积极寻找和拓展更多的市场应用领域，如智能物联网、WIFI音箱、生物识别、安防监控等。今年中报，公司实现营业收入3,089.94万元，同比增长14.33%；净利润67.96万元，同比增

长132.21%，业绩拐点已经初现。随着三季度业绩释放，公司全年的业绩基本确定反转。

前三季度业绩增大的公司还有国民技术、欧比特、通富微电、中环股份等。其中，国民技术预计前三季度实现净利润6400万元至6550万元，增长幅度为1121.84%至1150.48%。前期在移动支付领域栽过跟头的国民技术，目前业务已经从低谷中走出，公司金融IC卡芯片业务稳步推进，通过加强研发，做好市场准入、产品导入及推广，现在已经在部分商业银行开展试点发放工作。国内金融IC卡年发卡量近7亿张，前期海外龙头恩智浦垄断市场，未来几年国产化替代空间巨大。

欧比特、通富微电、中环股份预告前三季度最高净利润增幅均在50%以上。作为上半年创业板的大牛股，欧比特前三季业绩较中报业绩实现翻倍。公司前期收购的铂亚信息实现并表，产品线布局得到进一步完善。公司还按照年初规划开展SOC/SIP、飞控系统等产品的国际化市场推广工作。

分析人士表示，虽然半导体大环境仍然难言景气，但是不少上市公司在经营战略上进行微调，仍然取得好于去年同期的成绩。目前来看，在大周期下滑中，技术驱动的因素仍然客观存在，未来半导体行业还有不少增长空间。

两公司业绩亏损

18家公司中，共有4家公司业绩同比下滑。其中，七星电子预计前三季度净利润2871.47万元

至3948.27万元，增长幅度为-20.00%至10.00%；上年同期公司净利润为35893400元。福星晓程预计前三季度净利润3029.67万元至3462.48万元，下降幅度为30%至20%；上年同期公司净利润为43281000元。台基股份预计前三季度净利润1704.90万元至2045.87万元，下降幅度为50%至40%；上年同期公司净利润为34097900元。苏州固锝预计前三季度净利润为664.68万元至2326.38万元，下降幅度为80%至30%；上年同期公司净利润为33234000元。

共有两家公司前三季度业绩面临亏损。盈方微预计前三季度实现净利润-2489.29万元左右，基本每股收益为-0.0305元左右；上年同期业绩则为-13654100元，基本每股收益-0.0351元。康强电子预计前三季度净利润为-5000万元至-4500万元；上年同期则为25074000元。

盈方微今年以来业绩一直低于预期，业内认为其原因，一是公司原有芯片业务受平板市场增速萎靡和竞争激烈的影响，销售额低于预期；二是公司布局的OTT终端芯片等重量级新品，受广电行业政策影响，出货量低于预期；三是公司进行新产品研发，费用率出现较大增长。

目前上海贝岭、有研新材、长电科技、太极实业、中电广通、综艺股份、晶方科技等半导体企业尚未公布三季报业绩情况，但总体而言半导体行业今年业绩逐步走向复苏已是不争事实。不过，目前下游趋弱，半导体产业所处市场仍然不乐观。后续一系列并购的落地和国内半导体产业政策的渐次推进，将是行业内的主要看点。



CFP图片

紫光再显龙头地位

紫光股份9月30日宣布，拟以38亿美元（折合人民币240亿元）取得硬盘大厂西部数据（Western Digital）约15%的股权，一跃成为最大股东。

根据二者签署的协议，紫光股份旗下香港全资子公司紫光联合信息系统有限公司将以每股92.5美元的价格认购西部数据新发行的40814802股普通股。交易完成后，紫光股份将持有西部数据已发行在外的15%的普通股，成为后者第一大股东，并拥有一个董事会席位。

西部数据成立于1970年，总部位于美国加州，目前主要为全球个人电脑用户提供完善的存储解决方案。西部数据曾经是全球第一大硬盘生产商，但之后被希捷（Seagate）超越，不过仍然稳占全球第二大硬盘生产商的位置。

值得注意的是，有业内人士透露，本次对西部数据的入股也可能成为紫光收购美

国美光科技的铺垫。今年7月份，业内就有消

息传出，紫光希望以230亿美元全盘收购美

国国内存生产商美光科技公司。美光科技是全

球最大的半导体储存及影像产品制造商之

一，其主要产品包括DRAM、NAND闪存、

NOR闪存、SSD固态硬盘和CMOS影像传

感器。在传出与美光并购的“绯闻”之前，紫光

刚刚接盘收购了惠普中国子公司H3C（华

三通信）。

230亿美元的金额，如果成功，将会是中

国历史上最大海外并购。业内分析，紫光若

达成对美光的收购，将直接提升在存储领

域的话语权。因为一直以来，我国在存储领

域专利技术储备较弱，难以与国际巨头对抗。

据了解，美光目前各类存储芯片的月产能

能达到138万片，估值约400多亿美元。

因此，紫光对美光的出价，并不算特别高。

不过，当时有多位业内人士向中国证券报

记者表示，考虑到该领域涉及信息安全产业链中

非常敏感的部分，这笔交易很可能无法获得美国政府许可。事实让，截至目前，该笔交易并没有下文。

目前尚不清楚紫光和西部数据的谈判和交易细节，但业内普遍认为，此次对西部数据的入股，可能是紫光对收购美光的投石问路，也有可能是后续紫光对存储器领域布局的开始。

自2013年7月紫光收购在美国上市的芯片设计公司展讯之后，清华紫光就开始了其在半导体行业的扩张之路。2014年7月收购锐迪科，2015年5月收购惠普公司旗下的华三通

信，再加上获得中国国家集成电路产业基金

投资100亿人民币，紫光可以说是大陆半

导体产业的国家队先锋，也开启了国内新一轮

半导体产业并购的大潮。目前来看，这一趋势

仍然在不断深化和进行。本次交易更加凸显

出紫光在国内半导体领域的龙头地位，业内

对紫光后续的资本运作持有较高的期待。

志在补齐存储器短板

产业已经着手补齐存储器领域的短板。随着本次紫光对西部数据的入股，Flash相关储存设备也将成为中国半导体产业的发展重心之一。

针对此次收购，研究机构DRAMeX-change指出，除了对信息与通讯设备产业本土化的强化外，本次并购的一大亮点是强势参与到近年来高速成长的NAND Flash及SSD相关储存设备领域。

过去三年来，各大储存设备与硬盘厂积极加快在Flash储存领域的布局，并购案如火如荼进行，成交金额也水涨船高。西部数据在此领域已经砸下超过11亿美元，通过快速并购，西部数据本身所拥有的完整HDD与SSD全系列储存解决方案更显吸引力十足。

DRAMeXchange分析师杨文得表示，除了Flash芯片生产外，储存设备所衍生的产品应用、系统整合、软件/韧体/硬件/控制芯片等众多项目是NAND Flash产业不可缺少的发展关键因素。在中国半导体业积极往内存领域迈进的同时，NAND Flash芯片、产品供货商也将成为中国布局储存装置中的重点发展项目。因此，紫光入股西部数据的投资案极具有示范意义。

TrendForce研究报告指出，凭借紫光

集团充沛的财力及其进军半导体的决心，即使对美光的全资收购无法达成，也不排除可能以溢价的方式收购部分美光的股权。目前该收购提案仍在讨论阶段，但紫光

集团旗下紫光股份前期已公告因筹划重大

事项涉及资产重组而停牌，或与收购美光

一事不无关联。

该研报指出，对于美光而言，若能与清

华紫光在股权上达成合作的共识，在当前

DRAM与NAND Flash价格持续下滑的市

况下，无疑将获得资金面的保障。另一方面，

美光在DRAM领域相较小敌三星、海力士

要落后，市场占有率排名第三，若能与紫光

合作，将大幅提升其在中国地区的DRAM

出货量。目前中国市场对内存的消化量已

经占到全球总量21.8%，闪存更是占到25%，后

续提高的空间还很大。以高启全的背景，若

能就职紫光，不排除帮助撮合与美光合作

的可能性。

台湾地区的存储器独立发展多年，由于缺

乏核心技术，一直受制于人，其封装代工的产

业模式，在全球的产业链中并没有取得

强势地位。分析人士表示，大陆地区的存储

器发展应当坚持走技术路线，方可避免走台

湾地区的老路。

产业进入快速增长期

晶圆代工厂积极布局中国

□本报记者 傅嘉

力晶与安徽合肥市政府合资兴建的12寸晶圆厂，于10月20日举行动土仪式。这成为近期国内半导体产业又一个重大事件。据了解，双方总投资金额为人民币135.3亿元，初期会以0.15um切入，主要代工生产大尺寸LCD驱动IC，月产能4万片，预计2017年进入量产。

TrendForce最新发布的研究报告显示，从去年开始，半导体就已经被中国政府列入重点培植产业。受惠于政府的计划性补贴，大陆IC设计厂商以及下游系统厂商产品竞争力快速增强，全球市占率也在不断攀升。

卡位战开打

根据TrendForce旗下拓墣产业研究所的数据显示，自2009年以来，在强大市场购买力和自有品牌茁壮成长的推动下，中国IC设计产业的产值在全球市场的占比逐步攀升，预计在2015年有机会达到18.5%（2009年占比为7.1%），而销售产值更是以25%的年复合增长率高速增长。

TrendForce表示，中国IC设计厂商的订单需求量在未来3年内很可能是全球成长性最高的，为了搭上此波浪潮，2015-2017年将会是全球晶圆代工厂商争相布局卡位的重要时刻。

TrendForce指出，28纳米甚至更先进的14/16纳米制程能力，将是影响各厂商在中国市场版图变化的关键所在。如何与中国政府和中资企业进行策略联盟并获得其全力支持，如何实现双方利益最大化，将是获得胜利的另一项重要因素。

今年半导体产业经历了量与质的变化，从去年的7.2%成长，迅速下滑至今年的仅2%-3%微幅成长。TrendForce经理林建宏表示，2016年半导体产业将面对物联网的影响，厂商除了提供差异化的品以提升竞争力外，更需藉自身的差异化转型以应对下一波的浪潮。物联网将改变产品生产周期，并使部分厂商的产品价值因使用情境的不同而受压缩，但也衍生出新的价值区块等候填补。转型与调整将是2016年半导体业的首要课题。

积极布局中国

根据TrendForce介绍，联电在中国苏州的和舰厂8寸晶圆月产能约6-7万片，2016年暂无进一步扩产计划。联电以投资中国IC设计厂联芯的方式，自2015年起的5年内将投资13-14亿美元，在厦门兴建12寸晶圆厂，总投资规模为62亿美元，已于2015年3月份动工。初期会以40/55纳米制程切入市场，未来以转进28纳米为目标。厦门厂预计2016年年底至2017年年初投产生产，初期月产能1-2万片，未来会视情况进行扩充。联电是目前晶圆代工厂商中，在中国设厂脚步最快的公司。

中芯目前共有3座8寸晶圆厂，分别在上海、天津和深圳。其中，上海与天津的8寸厂月产能总计约13-14万片，深圳厂预计今年第四季度开始投产生产。2016年，中芯的8寸晶圆总产能可达每月15-16万片水平。其12寸厂房分别座落在上海和北京，月产能总计约5万片，2016年北京厂打算再增加约1万片月产能。中芯国际未来能否顺利突破28nm制程瓶颈，将是营运能否更上一层楼的观察重点。

台积电在中国上海松江8寸晶圆厂月产能约10-11万片。目前其内部正在评估去中国设置12寸晶圆厂的必要性。一旦确定设厂，在考虑建